

# QJ

## 中华人民共和国航天工业部部标准

QJ/Z 146~160-85

QJ 930~934-85

---

### 电子装联标准汇编

1985—10—01 发布

1985—10—01 实施

---

中华人民共和国航天工业部 批准

# 目 录

QJ /Z 146-85	导线端头处理工艺细则	( 1 )
QJ /Z 147-85	电子元器件搪锡工艺细则	( 13 )
QJ /Z 148-85	漆包线去漆膜工艺细则	( 19 )
QJ /Z 149-85	镀膜导线酸洗工艺细则	( 21 )
QJ /Z 150-85	导线热压打标记工艺细则	( 25 )
QJ /Z 151-85	螺纹连接胶封和点标志漆工艺细则	( 29 )
QJ /Z 152-85	圆导体带状电缆安装工艺细则	( 33 )
QJ /Z 153-85	MOS集成电路安装工艺细则	( 37 )
QJ /Z 154-85	印制电路板组装件装联工艺细则	( 41 )
QJ /Z 155-85	绕接工艺细则	( 51 )
QJ /Z 156-85	SO <sub>1-3</sub> 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则	( 59 )
QJ /Z 157-85	氮化硼浇注工艺细则	( 63 )
QJ /Z 158-85	汽相清洗工艺细则	( 73 )
QJ /Z 159.1-85	整机及部件密封灌注工艺细则	( 75 )
QJ /Z 159.2-85	印制电路板组装件灌封工艺细则	( 83 )
QJ /Z 159.3-85	局部封装工艺细则	( 87 )
<del>QJ /Z 159.4-85</del>	磁蕊板灌封工艺细则	( 91 )
<del>QJ /Z 160-85</del>	手工锡焊工艺细则	( 95 )
QJ 930-85	绕接技术条件	( 105 )
<del>QJ 931-85</del>	电子产品控制多余物规范	( 115 )

## 1 适用范围:

本标准采用 QD 2 3 1 嵌段室温硫化硅橡胶对航天电子产品的整机或部件进行密封灌注操作的指导性文件,通过对需要密封的部位进行灌注来达到密封产品的目的, QD 2 3 1 硅橡胶室温固化后为无色透明弹性体,它具有较高的抗张强度,耐高、低温,耐冲击及便于维修等特点。

## 2 材料,设备,工具

### 2.1 材料:

- a. QD 2 3 1 (分子量 5—7 万北京化工二厂)
- b. 固化剂(见附录 A)
- c. 表面处理剂(见附录 B)
- d. SF—7 4 0 5 有机硅漆(见附录 C)
- e. 辅助材料:无水乙醇或丙酮;硅油;GD 4 1 4 单组份硅橡胶或压敏胶带或浸腊棉线等堵漏材料。

### 2.2 设备,工具

- a. 抽真空箱(规格根据配料量选择)
- b. 天平(根据配料量确定精度)
- c. 烧杯(容量应大于配料量的两倍)
- d. 玻璃棒和搅拌器
- e. 滴管
- f. 镊子、胶乳海棉、狼毫笔

## 3 技术要求

### 3.1 密封灌注表面处理要求

密封灌注必须在产品调试、检验合格后进行,对有表面喷涂要求的产品应先进行喷涂工序后再进行密封灌注。对需进行密封灌注部位除允许喷涂 SF—7 4 0 5 有机硅漆外,不允许喷涂其它类型的漆。

### 3.2 清洁处理要求

对被密封灌注部位的清洁处理用无水乙醇或丙酮擦拭或清洗(视被灌注表面状况而定),被密封部位均要求清洁干净保证无污物,油垢,灰尘,多余物等。

### 3.3 灌注部位的表面处理

所有被灌注部位均要求进行表面处理——涂表面处理剂。视表面状况可选择下列之一。

3.3.1 产品(包括需密封部位)已喷、涂 SF—7 4 0 5 有机硅漆,则可不再进行表面处理。但应及时进行灌注操作。

3.3.2 对被灌注部位喷涂 SF—7 4 0 5 漆(喷涂工艺按附录 C),若采用涂或刷的方法时要求涂的均匀、致密。